



BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
			[μm]	[μm]
Folie	12 μm	1) 1×1080	12	
			60	
Folie	12 μm		30	
		1×1080	60	
	35 μm		33	
0,100 mm			100	
	35 μm		33	
		2×1080	124	
	35 μm		33	
0,100 mm			100	
	35 μm		33	
		2×1080	124	
	35 μm		33	
0,100 mm			100	
	35 μm		33	
		2×1080	124	
	35 μm		33	
0,100 mm			100	
	35 μm		33	
		1×1080	60	
Folie	12 μm		30	
		1×1080	60	
Folie	12 μm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 μm

Gesamtdicke Material:			1360
-----------------------	--	--	------

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	1,35	+/-	0,12	mm
DICKE über galv. Endoberfläche	1,44	+/-	0,15	mm
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,50	+/-	0,17	mm
Kundenforderung:	+/-	mm		

Datum:	Bearbeiter:
Messstelle:	

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision
28.03.2006	S. Keller	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R. Schönholz	00

Seite: 6+